

# 国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026—019

<b>投资者关系 活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
<b>参与单位名称 及人员姓名</b>	天风证券：王奕红、曾庆亮 汇丰晋信：严东 博时基金：高鑫 中南资本：陈顶立、陈志煌 混沌投资：黄琦越 渤海人寿：傅盈 中邮证券：徐铭婉 稳见投资：刘建 常春藤资产：陈雯雯 建信基金：陈广飞 徐氏兄弟：王洋
<b>时间</b>	2026 年 5 月 15 日
<b>地点</b>	国机精工下属企业郑州磨料磨具磨削研究所
<b>上市公司接待 人员姓名</b>	董事会秘书：赵祥功 投资者关系助理：汪智婷
<b>投资者关系活 动主要内容介 绍</b>	<p style="text-align: center;"><b>一、公司情况介绍</b></p> <p style="text-align: center;">（一）公司概况</p> <p>国机精工的历史，可追溯至 1958 年成立的洛阳轴承研究所和郑州磨料磨具磨削研究所，2005 年在深交所上市。轴研所是中国轴承行业唯一的国家级综合性研究机构、我国航空航天轴承领域的主要配套单位。三磨所是中国超硬材料行业唯一的国家级综合性研究机构，主导制定了中国超硬材料行业的绝大部分技术标准。在半导体领域，三磨所成功打破国外巨头对陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、划片刀、封装刀、减薄砂轮等关键耗材的长期垄断。</p> <p style="text-align: center;">（二）经营情况</p>

2025年，公司实现营业收入30.19亿元，同比增长13.59%；实现毛利总额10.29亿元，同比增长9.82%。实现归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，同比下降6.96%。归母净利润的下滑的原因是2025年3-4月，公司将超硬材料业务注入国机金刚石平台，公司对超硬材料业务的权益比例从100%降至67%，超硬材料业务创造的部分收益转为少数股东权益。2025年，公司少数股东损益为6,491.59万元，而2024年同期仅为1,028.14万元。若剔除这一因素，公司实际经营利润保持稳健增长。

公司业务基本盘由轴承及超硬材料两大板块构成。轴承业务主要分为特种轴承、风电轴承和精密机床轴承。2025年，轴承实现收入13.28亿元，同比增长25.56%。航天领域产品覆盖卫星用轴承组件及火箭燃料涡轮泵轴承，主要客户为国内主流的卫星、火箭制造公司（含民营）。

超硬材料业务分为六大业务板块，原料辅材、关键装备、金刚石结构化应用、金刚石功能化应用、培育钻石新消费和检测服务，利润主要来源于金刚石结构化应用，产品广泛应用于半导体、汽车、光伏等领域。2025年，金刚石结构化应用实现收入6.68亿元，同比增长约16%，毛利率63.4%，同比提升5.16个百分点，主要因为半导体领域贡献的收入占比提升，半导体领域主要竞争对手为国际企业，在半导体国产化浪潮下，公司将持续巩固技术引领地位，助力实现关键耗材的替代。

### （三）未来展望

超硬材料业务板块正迎来半导体行业发展的历史性机遇，随着国内晶圆厂持续扩产及先进制程迭代，划片刀、封装刀、陶瓷载盘等关键耗材需求放量。公司依托超硬材料磨具国家重点实验室技术积淀，已实现倒边轮减薄磨砂轮、划片刀、封装刀及陶瓷载盘/卡盘等高端产品批量供货，打破日系厂商垄断。金刚石功能化应用加速突破，以2025年千万级收入为起点，重点推进金刚石散热商业化落地、光学级金刚石大尺寸制备及应用，以及第四代半导体材料研发，持续打造国家战略科技力量。

轴承领域着力提升航天轴承的产能和智能化转型，满足配套商业航天重点主机需求。

## 二、交流环节

### 1. 问：超硬材料磨具业务开展情况如何？

	<p>答：2025 年超硬磨具业务收入 6.7 亿元左右，下游应用分半导体领域和非半导体（汽车、制冷、LED、工模具等）领域。其中用于半导体领域的产品近几年增长较为显著。公司超硬材料磨具产品性能优越，具有较高的技术门槛，竞争对手基本为国际跨国企业。</p> <p><b>2. 问：超硬材料磨具业务在半导体领域的开展情况？</b></p> <p>答：半导体业务近几年保持较快增长势头，主要驱动因素为中国半导体行业景气度较高和公司产品渗透率提升。产品端已覆盖倒边轮、减薄砂轮、划片刀、封装刀等金刚石工具，以及陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等精密陶瓷制品。</p> <p><b>3. 问：金刚石散热主流产品类型及市场如何比较？</b></p> <p>答：行业内主流产品分为单晶金刚石散热片、多晶金刚石散热片和金刚石铜复合材料三大类。单晶金刚石散热片热导率约 2000W/m·K 以上；多晶金刚石散热片的热导率约 1500W/m·K；金刚石铜复合材料热导率约 800W/m·K。市场主要从生产成本、生产工艺、下游适配场景等维度综合评估。</p> <p><b>4. 问：公司在金刚石散热领域的产品布局和进展？</b></p> <p>答：目前，金刚石散热片和金刚石光学窗口片已有小批量订单，主要供应国防工业领域，2025 年实现收入超 1000 万元。</p> <p>公司金刚石散热产品矩阵覆盖金刚石单晶、金刚石多晶和金刚石铜复合材料。目前，民用领域的产品已送样客户，若进展顺利有望在年内有小批量订单落地。</p> <p><b>5. 问：公司在散热领域产能布局情况，若下游需求大幅放量能否满足？</b></p> <p>答：以目前产品价格衡量，公司目前 MPCVD 产能对应产值大约在 1.5 亿元左右，至明年，产能对应产值大约在 2 亿元左右，可满足一定时段内的市场需求。公司也会根据市场情况，适时扩大产能。</p> <p><b>6. 问：公司在金刚石行业的核心竞争优势是什么？</b></p> <p>答：一是公司深耕金刚石领域多年，产业积淀深厚；二是依托国家级重点实验室的技术支撑，研发实力突出；三是自主研发金刚石生长及加工全流程设备，技术自主可控。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的</p>	<p>否</p>

说明	
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无